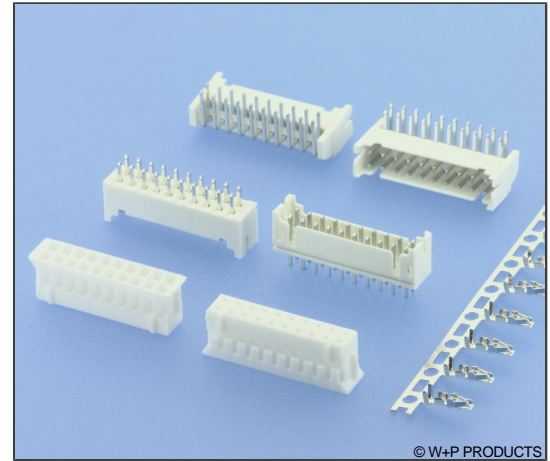


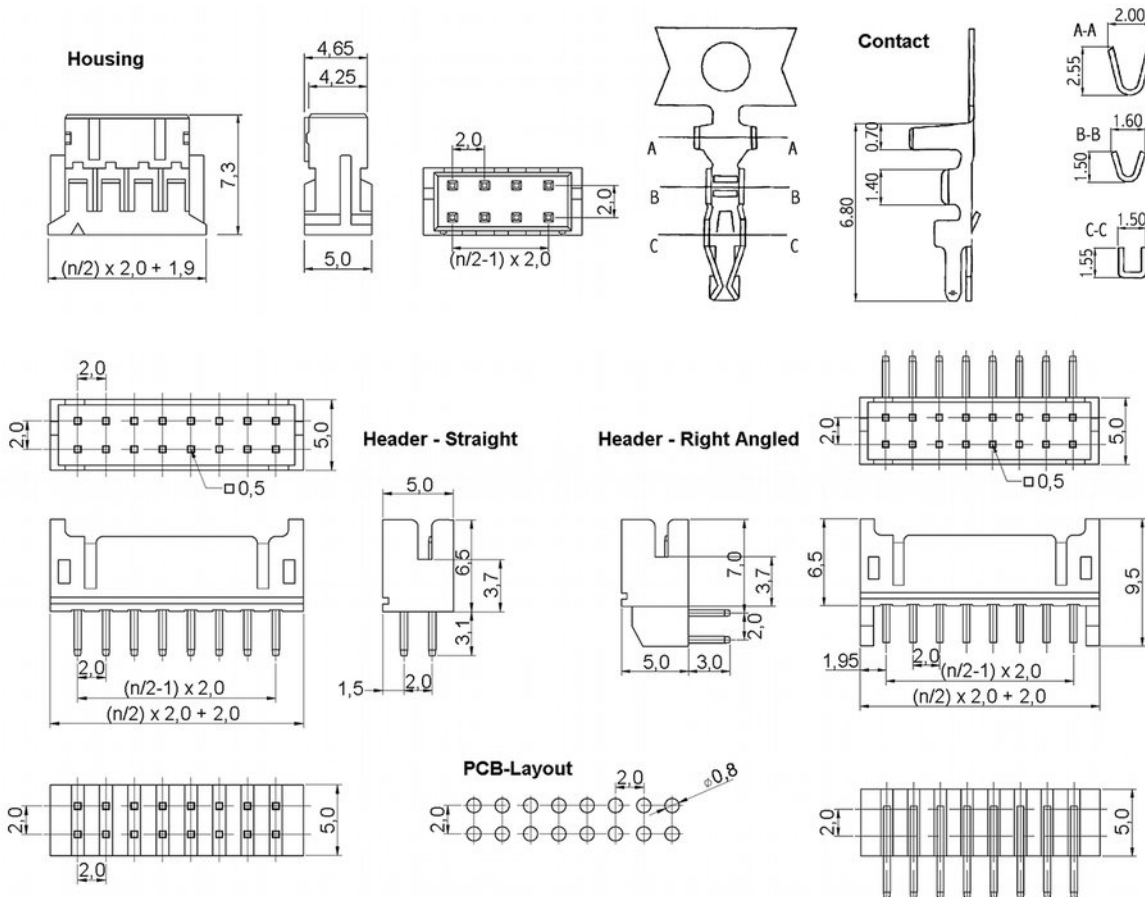
Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 2,00mm, gerade/gewinkelt Friction Lock Headers / Crimp Housings, 2.00mm Pitch, Straight/Right-Angled

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,50mm, Kupferlegierung <i>Square pin 0.50mm, copper alloy</i>
Aderquerschnitt <i>Applicable Wire Gauge</i>	AWG 28 ~ 22 <i>AWG 28 ~ 22</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ <i>< 20 mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ <i>> 1000 MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	800 V AC <i>800 V AC</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100 V AC <i>100 V AC</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	2 A <i>2 A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-25 °C ... +85 °C <i>-25 °C ... +85 °C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellenlötverfahren <i>Wave soldering</i>



© W+P PRODUCTS



Series

522

Contacts*

08

06-32 zweireihig
Double row
01 (für Buchsenkontakte)
(for crimp contacts)

Type*

3

1 Buchsengehäuse
Housing
2 Buchsenkontakte AWG 22-28
Crimp contacts AWG 22-28
3 Stiftleiste gerade
Straight pin header
4 Stiftleiste gewinkelt
Right-angled pin header

Plating

50

50 Verzinkt (für Gehäuse nicht erforderlich)
Tin plated (not necessary for housings)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:

